

**LISTA PUBLICAȚIILOR REZULTATE ÎN URMA CERCETĂRII DOCTORALE,  
PUBLICATE SAU ACCEPTATE SPRE PUBLICARE, SUB AFILIERE UPT**

**Ing. Iulia – Eliza ȚINCA**

**1. Lucrări științifice publicate în reviste indexate Web of Science-WoS (ISI)**

1. I. E. Ținca și A. Davidescu, „Analytical Fatigue Life Prediction of Ball Grid Array Solder Joints,” *Journal of Electronic Materials*, 2023 – *acceptată spre publicare*.

2.

**2. Lucrări științifice publicate în volumele unor manifestări științifice (Proceedings) indexate Web of Science-WoS (ISI) Proceedings**

1. I. E. Ținca, D. Faller și P. Rai, „System-Level Flip-Chip Ball Grid Array Solder Joint Reliability Assessment Under Different Methodologies and Correlation with Accelerated Thermal Cycling Experimental Data,” în *Electronics System-Integration Technology Conferences, Vestfold, 2020 (WOS:000631824100049)*

2. I. I. Ailinei, I. E. Ținca, A. M. Silaghi, C. Bleoju, A. Davidescu și L. Marșavina, „Evaluation of Finite Element Modelling Techniques of Printed Circuit Boards under Dynamic and Static Loading and Validation with Experimental Data,” în *2021 IEEE 27th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), Timișoara, 2021 (WOS:000786441900024)*

3. I. E. Ținca, I. I. Ailinei și A. Davidescu, „Printed Circuit Board Assembly Modeling for Predictive Reliability Assessment,” în *2022 IEEE 28th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2022, Bucharest, 2022 (WOS:000947243400013)*

**3. Lucrări științifice publicate în reviste de specialitate indexate BDI (cu specificarea BDI)**

1.

2.

**4. Lucrări științifice publicate în volumele unor manifestări științifice (Proceedings) indexate BDI (cu specificarea BDI)**

1. I. E. Ținca, „Optimized FE Model for System-Level Solder Joint Reliability Analysis of a Flip-Chip Ball Grid Array Package,” în *New Advances in Mechanisms, Mechanical Transmissions and Robotics, Timișoara, 2021 (Springer Link)*

2. I. E. Ținca, I. I. Ailinei și A. Davidescu, „Printed Circuit Board Orthotropic Material Calibration for Static and Dynamic Loading,” în *Electronics System-Integration Technology Conference, Sibiu, 2022 (IEEE Xplore)*

**5. Lucrări științifice publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale (Proceedings) din străinătate**

1.

2.

**6. Lucrări științifice publicate în volumele unor manifestări științifice**

1.

2.

AVIZAT, Conducător științific  
*Prof.univ.dr.ing. Arjana Davidescu*

ÎNTOCMIT, Student doctorand  
*ing. Iulia – Eliza Ținca*

**ANEXE atașate obligatorii**

**A)** Pentru Lucrări publicate indexate din Web of Science-WoS (ISI) (secțiunile 1-2), cu indicarea *WoS number* ex. WOS:000316957600003.

i) *Extras listat din Web of Science cu lucrări indexate (ISI).*

**B)** Pentru Lucrări nepublicate, trimise la Reviste indexate Web of Science (ISI) și acceptate final (secțiunea 1):

i) *Accept final de publicare trimis de editor,*

ii) *Dovada indexării revistei (valoare factor impact recent).*